

## 2021 年頡邦科技校外實習計畫(一年期)

|        |   |      |              |      |             |
|--------|---|------|--------------|------|-------------|
| 公司名稱   | 頡邦科技股份有限公司  |      |              |      |             |
| 負責人    | 吳非艱   | 統一編號 | 16130009     |      |             |
| 聯絡人    | 范小姐   | 部門   | 人力招募部        |      |             |
| 聯絡電話   | (03)567-8788 #22405   | 傳真   | (03)567-8690 |      |             |
| 公司地址   | (總部) 新竹市力行五路三號  |      |              |      |             |
| E-mail | <a href="mailto:christinefan@chipbond.com.tw">christinefan@chipbond.com.tw</a>  |      |              |      |             |
| 公司簡介   | <p>頡邦科技公司成立於 1997 年 7 月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，主要業務為提供顯示器驅動 IC 後段封裝及測試代工服務，其中驅動 IC 封裝包括前段之金凸塊製程與後段之 TCP 及 COG 封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸塊製作。</p> <p>2010 年合併案後，在金凸塊、Wafer test、COF、COG 的產能為全球第一大，目前為全球第一大驅動 IC 封裝公司。</p> <p>受惠 5G 手機滲透率大增、IC 客戶強勁拉貨動能等因素下，DIGITIMES Research 分析師陳澤嘉預估，2020 年台灣 IC 專業委外封測代工（OSAT）產值將突破 185 億美元，年增逾 15%。放眼 2021 年，在 IC 封測需求預估續強，竹科旁的湖口工業區，全球第九大封測廠頡邦科技的新廠房大樓，已進入完工階段。歡迎優秀學子加入頡邦科技，共創頡蹟！</p>  |      |              |      |             |
| 營業項目   | <p>◎營業項目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 金屬凸塊(Wafer Bumping Service)</li> <li>(2) 金凸塊(Gold Bump)</li> <li>(3) 錫鉛凸塊(Solder Bump)</li> <li>(4) 捲帶式軟板封裝(TCP)</li> <li>(5) 捲帶式薄膜覆晶(COF, Chip on Film)</li> <li>(6) 覆晶(Flip Chip)</li> <li>(7) 玻璃覆晶封裝(COG, Chip on Glass)</li> </ol> <p>◎產品營收比重分別為：</p> <p>8 吋金凸塊約佔 29%、12 吋金凸塊約 12%、晶圓測試約佔 1 成，COF(捲帶式覆晶薄膜封裝)約佔 22%、COG(玻璃覆晶封裝)約佔 10%、Tape(COF 載板)約佔 16%。COF 因可重封，其主要應用於大尺寸面板，COG 則多用在小尺寸面板。</p> <p>◎以應用分：</p> <p>TV 佔約 45%、手機佔約 25%、平板電腦佔約 10、PC 及 NB 佔約 25%。</p> |      |              |      |             |
| 資本額    | 65 億元   | 年營業額 | 204 億元       | 員工人數 | 6,000 人(台灣) |

### 實習資訊說明

| 實習系別/地點 | 工作項目  | 名額  |
|---------|---|---|
| 理工學院    | ※設備類<br>1.半導體機台維護與保養<br>2.現場機台異常排除<br>3.治工具維護<br>※製程類<br>1.製程穩定性監控與維護<br>2.製程異常排除與改善<br>3.工程實驗與資料蒐集分析<br>※廠務類<br>1. 廠務相關設備巡檢助理<br>2. 廠務系統定期保養維護<br>3. 工程改善數據量測蒐集  | 1. 設備類、製程類，共 4 名。<br>(地點：新竹科學園區。需輪班，日班)<br>2. 廠務類，共 4 名。<br>(地點：新竹科學園區、湖口工業區、高雄加工出口區，常日班) |
| 訓練與管理   | 1. 實習地點：新竹科學園區(新竹市)、湖口工業區、高雄加工出口區。<br>2. 一年期全時實習(學分需先修畢)，須配合實習工作需求安排班別。<br>3. 實習生除比照正式員工，於報到時接受新進人員訓練外，實習部門將視工作需要給予必要之訓練。<br>4. 實習生於實習期間須遵守公司之相關管理規定、請假、加班、門禁管理及行為規範等。<br>5. 實習期間將安排輔導人員從旁協助實習生工作學習；除此，亦會定期舉辦實習座談會了解同學實習狀況。   |   |
| 薪 資     | ■做四休二或做三休三，月薪日班 26,600 元起。<br>■常日班，月薪 24,500 元。   |   |
| 膳宿狀況    | ■公司提供午、晚餐(個人負擔 25 元/餐)<br>■公司提供 <u>新竹地區</u> 外縣市同仁宿舍 (1,500 元/月。宿舍前三個月免費-雙人房)  |   |
| 提供保險    | ■勞保    ■健保    ■團體保險   |   |
| 工作時間    | ■日班：07:20~19:20，輪休<br>■常日班：8:30~17:30，周休二日  |   |
| 加班情況    | <input type="checkbox"/> 不必加班 <input checked="" type="checkbox"/> 偶而 <input type="checkbox"/> 常態性加班   | 預估每月平均須加班時數<br>依需求調整，非固定  |
| 福利制度    | (1) 報到第一天即加保勞保、健保、團保，提供完整的工作保障。<br>(2) 提供冷氣宿舍，二人一室每月 1500 元，前三個月免費(電費另計)。<br>(3) 提供實習獎助學金最高 30,000 元。<br>(4) 提供公司內部用餐補助、外部特約廠商員工優惠折扣等福利。<br>(5) 獎勵實習生勇敢踏入職場學習，提供獎助學金，並期勉同學能夠儘早取得就業入場券。<br>(6) 鼓勵實習生優良表現，畢業後持續留用頌邦， <u>年資續計並提供高額留用獎金</u> 給予嘉勉。<br>(7) 實習屆滿前，協助職涯發展與提供內部轉任機會。 |   |
| 申請方式    | 請填寫「頌邦科技候選人履歷表(實習生)」，掃描或郵寄檔案至承辦人 <u>范小姐</u> 收(christinefan@chipbond.com.tw);後續將電話通知面試時間，進行實習甄選。   |   |

## 頡邦科技候選人履歷表（實習生）

本公司將依照個人資料保護法蒐集、處理與利用您以下所提供的個人資料。詳細資訊請參照本履歷表最末頁之說明。

| 應徵部門   |                 | 應徵職務 |       | 填寫日期           | 年  | 月   | 日  |       |
|--|-----------------|------|-------|----------------|--|-----|----|-------|
| <b>A.基本資料</b>                                  |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 姓名   |                 |      | 身分證編號 |                |  |     |    | 照片黏貼處 |
| 戶籍地  | □□□             |      | 電話    |                |  |     |    |       |
| 通訊處  | □□□ (□同上)       |      | 電話    | (家中):<br>(手機): |  |     |    |       |
| E-mail   |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| <b>B.教育、專長</b>                                 |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 學位   | 校名              | 科系   | 學制    |                | 就學期間   |     | 畢業 |       |
|  |                 |      | 日校    | 夜校             | 起  | 迄   | 是  | 否     |
| 國中   |                 |      |       |                | 年 月  | 年 月 |    |       |
| 高中(職)  |                 |      |       |                | 年 月  | 年 月 |    |       |
| 專科   |                 |      |       |                | 年 月  | 年 月 |    |       |
| 大學(四技)   |                 |      |       |                | 年 月  | 年 月 |    |       |
| <b>C.工作經驗</b>                                  |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| *工作經驗請依時間，由最近一份工作開始填寫                          |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 服務期間   | 服務機構<br>服務部門/職稱 | 工作內容 | 薪資    | (欲)離職原因        | 外部年資認可<br>由面談主管:_____勾選  |     |    |       |
| 1  | 年 月~<br>年 月     |      |       |                | <input type="checkbox"/> 相關 <input type="checkbox"/> 部分相關 <input type="checkbox"/> 不相關 |     |    |       |
| 2  | 年 月~<br>年 月     |      |       |                | <input type="checkbox"/> 相關 <input type="checkbox"/> 部分相關 <input type="checkbox"/> 不相關 |     |    |       |
| <b>D.個人簡述</b>                                  |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 1.請簡述您的家庭狀況：                                   |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 2.請簡述您的個性及嗜好：                                  |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 3.您喜歡擔任任何種職務？您最得意的專長為何？                        |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 4.您應徵本公司的主因是？                                  |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 5.對於工作，您一心追求的是？為什麼？（追求例如：薪資/成就感/穩定性/挑戰性.....等） |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 6.與人相處時如發生衝突，您將如何反應？您處理的步驟為何？                  |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| 7.請簡述在過去(求學或工作)經驗中最具成就感的事？為什麼？                 |                 |      |       |                |  |     |    |       |
| <b>E.其他</b>                                    |                 |      |       |                |  |     |    |       |

目前是否有親戚或朋友在頤邦任職？

無 有，姓名\_\_\_\_\_ 關係\_\_\_\_\_ 部門\_\_\_\_\_ 職稱\_\_\_\_\_

您是從何處得知此職缺？

親友介紹 報紙廣告 就服站 人力銀行網站 其他(\_\_\_\_\_)

您過去是否曾參與本公司面試？ 是，應徵單位\_\_\_\_\_ 否

是否需申請公司宿舍：是 否

預計可到職日：隨時 預計日期： 年 月 日

是否需提供素食餐飲：是 否

◎本人承諾上表內所填各項資料皆為屬實，謹此授權頤邦科技得就本人於此履歷表中所提供之陳述與個人資料內容之正確性進行確認。本人充分瞭解在此履歷表中所為之一切陳述如有虛偽不實，願依勞基法第 12 條第一款及刑法偽造文書之相關罰則辦理。

◎本人並特此同意及授權頤邦科技及其關係企業、頤邦科技及其關係企業之職工福利委員會所委託之第三人為招募聘用、人事管理及業務執行之目的，在符合個人資料保護相關法令之範圍內，蒐集、於國內與國際間處理、利用本人已經提供及未來將提供的個人資料。

◎本人已詳閱上開內容，並確認本人已瞭解且已依個人資料保護法及相關法令之規定受告知本人人事資料表內個人資料之蒐集目的、個人資料類別、利用之期間、地區、對象及方式、依個人資料保護法第三條規定得行使之權利及權利行使方式、及不提供本人本履歷表內個人資料時將對本人權益之影響。

填寫人簽名：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_